

NVIDIA 携手 SK Hynix 共建 AI 内存与半导体智造新生态

——电子行业周报（20260608-20260614）

行业及产业
电子

强于大市

一年内行业指数与沪深 300 指数对比走势：



资料来源：聚源数据，爱建证券研究所

相关研究
《电子行业专题报告：Vera Rubin 量产提速，RTX Spark 打开终端 AI 新空间》2026-06-08
《电子行业周报：端侧 AI PC 产业化落地，云端算力需求持续爆发》2026-06-08
《电子行业周报：长鑫科技 IPO 迎来关键节点，Intel 加码玻璃基板与硅光子》2026-06-01
《电子行业专题报告：华为发布 τ 定律，助力后摩尔时代半导体产业发展》2026-05-28
《电子行业周报：AI 算力高景气延续国产存储替代加速》2026-05-25

证券分析师

许亮
S0820525010002
0755-83562506
xuliang@ajzq.com

联系人

朱俊宇
S0820125040021
021-32229888-25520
zhujunyu@ajzq.com

- 投资要点：**
- **电子板块行情复盘：**本周 SW 电子指数下跌 1.87%，跑输沪深 300 指数（-0.82%），在 SW 一级行业指数中排名 15/31，板块阶段性震荡调整，周五盘面迎来小幅反弹。各细分板块中，半导体材料（+12.68%）、半导体设备（+9.78%）涨幅居前，面板（-10.01%）、LED（-9.97%）等回调明显，板块内行情分化显著。
 - **个股方面：**本周电子板块内涨幅前五个股分别为富信科技（+70.21%）、中巨芯（+55.41%）、金安国纪（+54.54%）、阿石创（+39.46%）、方邦股份（+39.09%）；跌幅前五分别为美迪凯（-27.59%）、春秋电子（-26.89%）、钧崴电子（-24.75%）、本川智能（-23.30%）、胜业电气（-22.95%）。
 - **2026 年 6 月 8 日，NVIDIA 与 SK Hynix 宣布联合研发下一代 AI 场景专用内存，并将 AI 技术落地至芯片设计与半导体制造环节。**1) SK Hynix 将针对 NVIDIA Vera Rubin AI 超算、Vera CPU、RTX Spark PC、Jetson Thor 机器人计算平台开发专用内存，切入 NVIDIA 布局的 AI 基础设施、个人 AI、物理 AI 等市场。2) 制造端，SK Hynix 将依托 CUDA-X 库、PhysicsNeMo 框架提速芯片仿真与光刻计算流程，并借助 Omniverse、cuOpt 搭建晶圆厂数字孪生体系，助力产线自主运营。我们认为，本次合作涵盖专用内存定制、AI 赋能制造两大领域，将加速全球 AI 产业链生态重构。
 - **Google 委托 Intel 制造超过 300 万颗 TPU 芯片。**据 The Information 2026 年 6 月 8 日报道，受 TSMC 先进制造与先进封装产能持续紧张影响，Google 已向 Intel 下达超 300 万颗下一代 TPU 芯片代工订单，该产品预计 2028 年投产。此外，NVIDIA 已参与 Intel 18A 制程及先进封装方案的早期测试，SK Hynix 也在开展 HBM 产品与相关封装技术的适配验证，若测试顺利，Intel 在 AI 芯片供应链的话语权将持续提升。我们认为，TSMC 高端产能承压推动订单分流，叠加多家头部企业同步开展测试适配，高端 AI 芯片代工正式迈入多元化发展阶段，Intel 在 AI 供应链中的战略地位有望进一步提升。
 - **投资建议：建议关注国产存储产业链及 AI 制造赋能相关投资机会：**NVIDIA 与 SK Hynix 本次合作，标志着全球 AI 产业链由垂直分工转向生态绑定。双方联合研发全平台专用内存，卡位 AI 内存核心增量市场，HBM 及上下游产业链景气度有望维持高位。同时，AI 技术全面渗透半导体制造全流程，有望重构生产模式、提升良率与生产效率，为半导体设备、工业软件、EDA 赛道带来成长机遇。
 - **风险提示：1) 生态闭环加剧国产厂商边缘化：**NVIDIA 与 SK Hynix 为多款平台定制专用 AI 内存，搭建软硬件封闭生态并形成技术与供应壁垒。国产厂商通用 HBM 产品难以匹配其性能标准，份额及盈利空间或持续承压。2) **海外 AI 制造技术体系封闭，国产产业链落地遇阻：**NVIDIA 全套 AI 工具链专属适配 SK Hynix 产线，对外壁垒较高。国内设备、工业软件及 EDA 企业难以完成技术适配，AI 赋能制造的推进节奏不及预期。

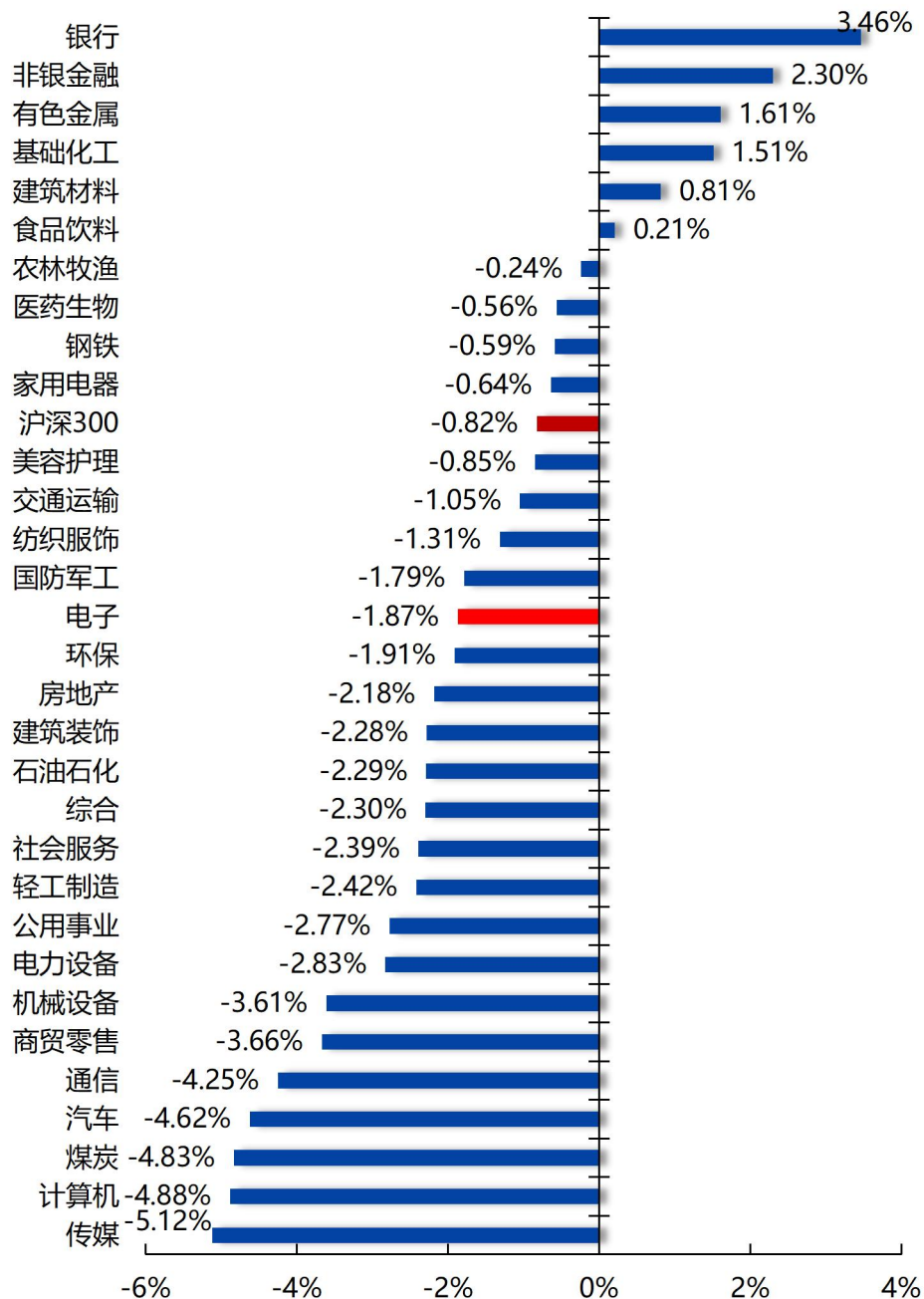
1. 本周市场回顾

1.1 SW 一级行业涨跌幅一览

本周 SW 电子指数下跌 1.87%，跑输沪深 300 指数（-0.82%），在 SW 一级行业指数中排名 15/31，板块阶段性震荡调整，周五盘面迎来小幅反弹。

SW 一级行业涨跌幅排名前五的板块分别为：银行（+3.46%）、非银金融（+2.30%）、有色金属（+1.61%）、基础化工（+1.51%）、建筑材料（+0.81%）。排名后五的板块分别为：传媒（-5.12%）、计算机（-4.88%）、煤炭（-4.83%）、汽车（-4.62%）、通信（-4.25%）。

图表 1：本周 SW 一级行业涨跌幅一览



资料来源：iFinD，爱建证券研究所

1.2 SW 电子三级行业市场表现

本周 SW 电子三级行业分化显著，涨跌幅排名前三的细分赛道分别为半导体材料（+12.68%）、半导体设备（+9.78%）、电子化学品Ⅲ（+3.18%）；涨跌幅排名后三的细分赛道分别为面板（-10.01%）、LED（-9.97%）、集成电路封测（-8.63%）。

图表 2：本周 SW 电子三级行业涨跌幅一览

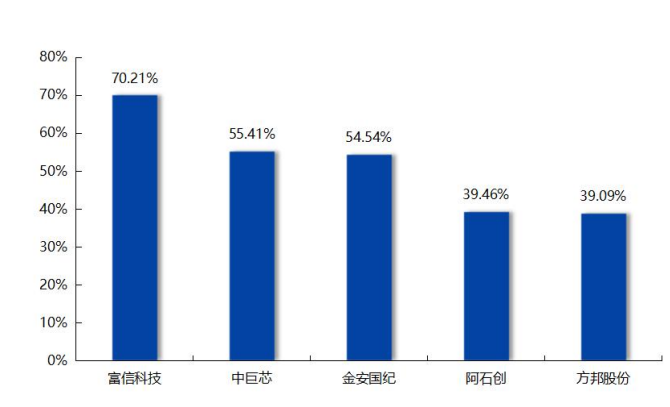


资料来源：iFinD，爱建证券研究所

1.3 SW 电子行业个股情况

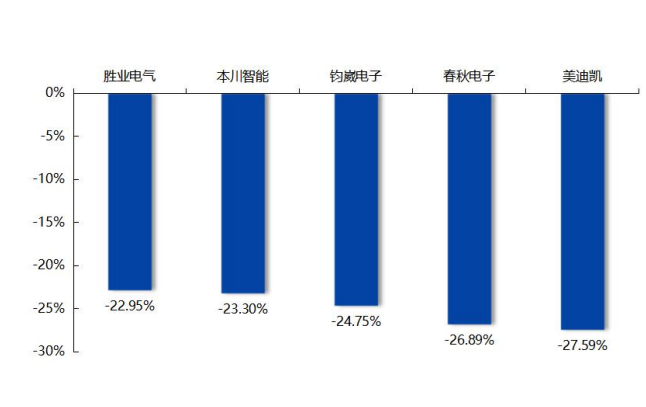
本周 SW 电子板块内个股分化加剧，涨幅前五的个股分别为富信科技（+70.21%）、中巨芯（+55.41%）、金安国纪（+54.54%）、阿石创（+39.46%）、方邦股份（+39.09%）；跌幅前五的个股分别为美迪凯（-27.59%）、春秋电子（-26.89%）、钧崴电子（-24.75%）、本川智能（-23.30%）、胜业电气（-22.95%）。

图表 3：SW 电子个股本周涨跌幅前五



资料来源：iFinD，爱建证券研究所

图表 4：SW 电子个股本周涨跌幅后五

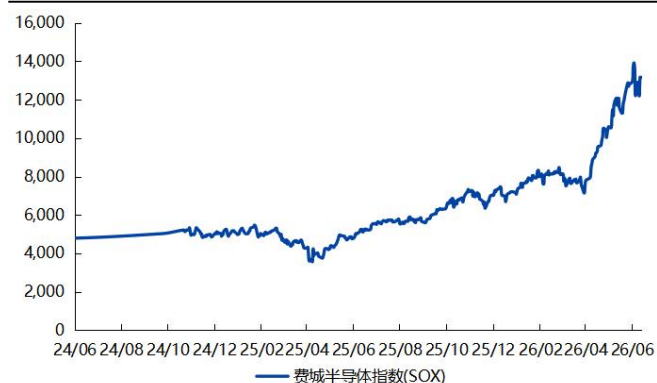


资料来源：iFinD，爱建证券研究所

1.4 SW 科技行业其他市场表现

费城半导体指数 (SOX) 本周涨跌幅为+9.42%，恒生科技指数本周涨跌幅为-3.75%。

图表 5：本周费城半导体指数涨跌幅为+9.42%



资料来源：iFinD，爱建证券研究所

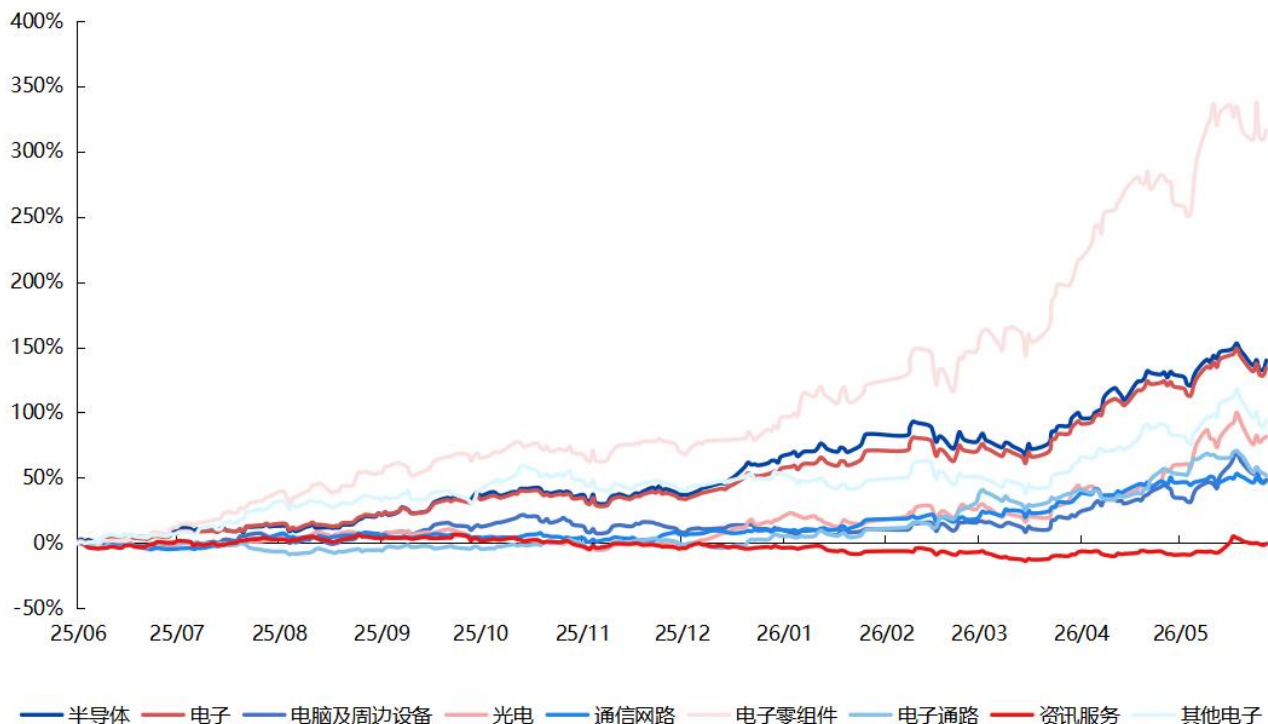
图表 6：本周恒生科技指数涨跌幅为-3.75%



资料来源：iFinD，爱建证券研究所

中国台湾电子指数各细分板块本周涨跌幅分别为：电子零组件 (+0.31%)、通信网路 (-1.80%)、资讯服务 (-1.92%)、半导体 (-2.10%)、电子 (-2.44%)、光电 (-3.73%)、其他电子 (-6.42%)、电脑及周边设备 (-7.54%)、电子通路 (-8.42%)。

图表 7：2025 年 6 月-2026 年 6 月中国台湾电子指数涨跌幅一览



资料来源：iFinD，爱建证券研究所

2. 全球产业动态

2.1 NVIDIA 与 SK Hynix 宣布联合研发下一代 AI 工厂专用内存

新闻：2026 年 6 月 8 日，NVIDIA 与 SK Hynix 宣布联合研发下一代 AI 工厂专用内存，并将 AI 技术应用于半导体芯片设计与制造。

1) SK Hynix 将为 NVIDIA Vera Rubin AI 超级电脑、Vera CPU、RTX Spark PC 及 Jetson Thor 机器人计算平台协同开发专用内存，进而进入 NVIDIA 正在开拓的 AI 基础设施、Personal AI 及 Physical AI 等市场。

2) 在半导体制造领域，SK Hynix 将采用 NVIDIA CUDA-X 库及 PhysicsNeMo 框架加速芯片仿真和光刻计算 workflow；同时借助 NVIDIA Omniverse 和 cuOpt 构建晶圆厂数字孪生，推动晶圆厂实现自主化运营。

爱建观点：NVIDIA 与 SK Hynix 此次合作，标志着全球 AI 产业链从垂直分工向生态绑定演进。双方联合研发全平台专用内存，锁定未来 AI 内存增量市场，HBM 及相关产业链景气度有望持续超预期。同时，AI 技术全面渗透半导体制造全流程，覆盖芯片仿真、光刻计算到晶圆厂数字孪生，推动 AI 工厂时代加速到来，将重构半导体制造生产方式，提升良率与生产效率，为半导体设备、工业软件及 EDA 产业链带来成长机遇。

2.2 Google 委托 Intel 制造超过 300 万颗 TPU 芯片

新闻：据 The Information 2026 年 6 月 8 日报道，由于 TSMC 先进制造与先进封装产能持续紧张，Google 已向 Intel 下达超过 300 万颗下一代 TPU 芯片的代工订单，预计 2028 年开始生产。

除 Google 外，NVIDIA 已参与 Intel 18A 制程及先进封装方案的早期测试。SK Hynix 亦在验证 HBM 产品与该封装技术的适配性。测试如若顺利，Intel 在 AI 芯片供应链的话语权将持续增强。

爱建观点：受 TSMC 先进制程与封装产能持续紧张影响，Google 已向 Intel 下达大额 TPU 代工订单，NVIDIA、SK Hynix 也同步开展工艺与适配测试，标志着高端 AI 芯片代工格局进入多元化阶段，Intel 有望在 AI 供应链中占据更重要的战略位置。

2.3 燧原科技科创板 IPO 将于 6 月 15 日上会

新闻：据中证网 2026 年 6 月 9 日报道，AI 芯片领军企业，与摩尔线程、沐曦股份、壁仞科技并称“国产 GPU 四小龙”。公司专注于自主研发云端 AI 训练与推理芯片，已迭代 5 款云端 AI 芯片，构建了涵盖 AI 芯片、加速卡、智算一体机、液冷算力集群及配套软件的完整产品体系。

燧原科技招股书显示，公司拟募资 60 亿元：15.03 亿元、11.97 亿元分别用于第五、六代 AI 芯片研发及产业化，33 亿元投入 AI 软硬件协同创新项目。

爱建观点：燧原科技本次 IPO 募资落地，将加快其第五、六代云端 AI 芯片研发与产业化进程，推动国产 AI 芯片技术迭代与软硬件协同创新，助力国内 AI 算力供给能力提升与供应链自主可控。

2.4 SpaceX 正式完成 750 亿美元规模 IPO

新闻：据快科技 2026 年 6 月 12 日报道，马斯克旗下 SpaceX 完成 750 亿美元 IPO。本次发行价 135 美元/股，发行约 5.6 亿股，创下全球史上最大 IPO 募资纪录。

管理权上，马斯克通过超级投票权股份类别保留了 85.1% 的投票控制权，这意味着 SpaceX 股东实际上买入的只是经济权益。董事会构成、资本配置及战略转型决策均由马斯克一人主导。

本次募资将用于扩建发射设施、升级运载火箭、扩充星链卫星星座、布局 AI 算力基础设施等核心业务，并偿还部分过桥贷款。

爱建观点：SpaceX 创新构建“精英核心+远景叙事”IPO 架构，引领 AI 与航天时代科技估值新范式，助力企业上市后实现长期高速增长。

3. 风险提示

1) 生态闭环加剧国产厂商边缘化：NVIDIA 与 SK Hynix 为多款平台定制专用 AI 内存，搭建软硬件封闭生态并形成技术与供应壁垒。国产厂商通用 HBM 产品难以匹配其性能标准，份额及盈利空间或持续承压。

2) 海外 AI 制造技术体系封闭，国产产业链落地遇阻：NVIDIA 全套 AI 工具链专属适配 SK Hynix 产线，对外壁垒较高。国内设备、工业软件及 EDA 企业难以完成技术适配，AI 赋能制造的推进节奏不及预期。

爱建证券有限责任公司

上海市浦东新区前滩大道 199 弄 5 号

电话: 021-32229888

传真: 021-68728700

服务热线: 956021

邮政编码: 200124

邮箱: ajzq@ajzq.com

网址: <http://www.ajzq.com>

评级说明

投资建议的评级标准

报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 个月内的相对市场表现，也即以报告发布日后的 6 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场：沪深 300 指数（000300.SH）；新三板市场：三板成指（899001.CSI）（针对协议转让标的）或三板做市指数（899002.CSI）（针对做市转让标的）；北交所市场：北证 50 指数（899050.BJ）；香港市场：恒生指数（HIS.HI）；美国市场：标普 500 指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）。

股票评级

买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 15%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5% ~ 15% 之间
持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 -5% ~ 5% 之间
卖出	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于 -5%

行业评级

强于大市	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
弱于大市	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告采用信息和数据来自公开、合规渠道，所表述的观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的独立看法。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法可能存在局限性，请谨慎参考。

法律主体声明

本报告由爱建证券有限责任公司（以下统称为“爱建证券”）证券研究所制作，爱建证券具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管。

本报告是机密的，仅供我们的签约客户使用，爱建证券不因收件人收到本报告而视其为爱建证券的签约客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但爱建证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供签约客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，爱建证券及其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测后续可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，爱建证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

版权声明

本报告版权归爱建证券所有，未经爱建证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用。否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、转载、刊登和引用者承担。版权所有，违者必究。